

金屬彈片導電膜-EMI 銀漿阻抗高的分析與解決

原因與解決方法:

1.EMI 油墨烘烤時間溫度不夠未烤幹. .(整體阻抗高)

---調整烘烤時間溫度,需考慮材料變形會否影響 DOME 組裝.
或離形膜難撕離)

2.EMI 油墨本身含銀量低.(整體阻抗高)

---更換油墨使用.

3.EMI 油墨使用前未攪拌平均.(局部阻抗高)

---油墨使用前攪拌 15-20 分鐘,無氣泡為準.

4.EMI 印刷膜厚不均或薄油.(局部阻抗高)

--調整印刷刮刀壓力和角度或更換刮膠.

5.EMI 設計網格間隙大或線細.(整體阻抗高)

---依 EMI 設計尺度,

6.EMI 中間大面積斷開.(局部阻抗高)

---依 EMI 設計尺度,

7.添加稀釋劑過多.(整體阻抗高)

---添加稀釋劑一般為 3%,不易過多

8.添加稀釋劑後未攪拌平均.(局部阻抗高)

---油墨使用前攪拌 15-20 分鐘